

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

公告编号：2024-052

芯联集成电路制造股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/4/15，由董事长丁国兴先生提议
回购方案实施期限	2024/4/13~2025/4/12
预计回购金额	20,000 万元~40,000 万元
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	6,725.3189 万股
累计已回购股数占总股本比例	0.9535%
累计已回购金额	26,998.2448 万元
实际回购价格区间	3.88 元/股~4.13 元/股

一、回购股份的基本情况

2024 年 4 月 13 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机用于股权激励计划及/或员工持股计划，回购价格不超过人民币 7 元/股（含）；回购资金总额不低于人民币 20,000.00 万元（含），不超过人民币 40,000.00 万元（含）；回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-022）、《芯联集成电路制造股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-029）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：

2024 年 6 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 49,467,604 股，占公司总股本 7,053,657,113 股的比例为 0.7013%，回购成交的最高价格为 4.13 元/股，最低价格为 3.89 元/股，成交总金额 198,985,004.68 元（不含交易费用）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 67,253,189 股，占公司总股本 7,053,657,113 股的比例为 0.9535%，回购成交的最高价格为 4.13 元/股，最低价格为 3.88 元/股，成交总金额 269,982,447.99 元（不含交易费用）。

上述回购进展符合既定的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会
2024 年 7 月 2 日